



Характеристика

Однокомпонентный, низковязкий, горячего отверждения. Вязкость клея обеспечивает его нанесение на автоматическом оборудовании методом «отпечатка» без нитеобразования

Основные сферы применения

Применяется для приклеивания полупроводниковых кристаллов к стеклотекстолитовым платам в процессе изготовления электронных устройств

Техническая консультация

Желатинизация, ч/град.С	Предел прочности СтЗ, МПа		Относительное удлинение при разрыве, %	Модуль упругости, ГПа	Ударный сдвиг, см
	при отрыве	при сдвиге			
—	—	6	—	—	—

По вопросам приобретения клея ГИПК-23-13 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов